适配板材

★ 中高Tg无卤环氧

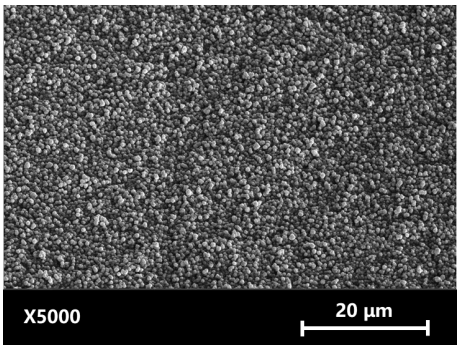
★ BT/类BT

典型应用

★ Coreless 制程

★ HDI高密度互联

★ IC封装载板



技术指标

项目		单位	规格参数	测试方法
标称厚度		μm	3.0	IPC-4562A
单位面积质量		g/m²	30	IPC-TM-650 2.2.12
薄铜粗糙度 Rz	压合面	μm	1.3	IPC-TM-650 2.2.17
载铜粗糙度 Rz	阻剂面	μm	3.0	
分离力	FR4	N/m	20	IPC-TM-650 2.4.8.4
薄铜剥离强度	FR4	lb/inch	4.0	IPC-TM-650 2.4.8
载铜剥离强度	FR4	lb/inch	2.5	

★ 以上数据为典型值，非保证值。

★ 半固化片会影响剥离强度，铜箔使用前请进行半固化片匹配实验或咨询德福科技技术服务人员。